



Ministero dell'Università e della Ricerca  
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Avviso per la *“Concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione”* da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 4, *“Istruzione e Ricerca”* - Componente 2, *“Dalla ricerca all'impresa”* -  
Linea di investimento 3.1, *“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”*,  
finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

## **ALLEGATO 4 - PIANO DEI PAGAMENTI**

## Piano dei pagamenti - Proposta progettuale ITEC0000005

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO	DATA AVVIO ATTIVITÀ	DURATA (in mesi)	COSTO TOTALE (€)	PAGAMENTI PREVISTI (€)
1	Appointment of the Infrastructure Manager	31/12/2022	6	1.050.000,00	514.500,00
2	Clean Room Realization	31/12/2022	36	4.009.500,00	1.964.655,00
3	Direct Laser Lithography	30/06/2023	15	1.050.000,00	514.500,00
4	Electron Beam Lithography	30/11/2023	21	2.310.000,00	1.131.900,00
5	Spin coating/developing/pre- and post-bake	30/06/2023	14	315.000,00	154.350,00
6	Wet chemical benches	30/06/2023	14	525.000,00	257.250,00
7	Spin dryers	30/06/2023	14	210.000,00	102.900,00
8	Plasma-Enhanced CVD system	30/11/2023	21	1.890.000,00	926.100,00
9	Low Pressure CVD system	30/11/2023	21	1.890.000,00	926.100,00
10	Electron Beam Evaporator	31/07/2023	21	1.260.000,00	617.400,00
11	DC/RF Sputter Deposition System	30/09/2023	24	1,260.000,00	617.400,00
12	Atomic Layer Deposition	31/01/2024	20	1.050.000,00	514.500,00
13	MOCVD reactor for oxides	31/01/2024	23	1.470.000,00	720.300,00
14	CVD reactor for 2D materials	31/01/2024	19	1.470.000,00	720.300,00
15	LP-CVD reactor for poly SiC	31/01/2024	20	1.575.000,00	771.750,00

16	CVD reactor for 200mm SiC epitaxy	31/01/2024	23	3.150.000,00	1.543.500,00
17	Inductively Coupled Plasma (ICP) dry etcher	30/09/2023	21	1.365.000,00	668.850,00
18	Rapid Thermal Annealing (RTA) system	30/09/2023	11	1.050.000,00	514.500,00
19	High-temperature furnace for SiC dopant activation	30/09/2023	25	1.050.000,00	514.500,00
20	High-temperature oxidation furnace for SiC	30/09/2023	25	1.050.000,00	514.500,00
21	Horizontal furnaces (multiple tubes)	31/07/2023	20	1.575.000,00	771.750,00
22	Ion-implanter with hot implantation capability	30/11/2023	25	4.483.500,00	2.196.915,00
23	Chemical Mechanical Polishing	29/02/2024	15	525.000,00	257.250,00
24	Optical microscope	31/08/2023	12	367.500,00	180.075,00
25	Profilometer	31/08/2023	16	262.500,00	128.625,00
26	Spectroscopic Ellipsometer	31/01/2024	17	367.500,00	180.075,00
27	Non-contact sheet resistance and Hall effect measurements	30/06/2024	18	472.500,00	231.525,00
28	Hg-probe system	30/06/2024	16	315.000,00	154.350,00
29	Probe station for in-line wafer-level testing	30/06/2024	16	1.050.000,00	514.500,00
30	Digitalization and Testing of the pilot-line	30/11/2023	25	882.000,00	432.180,00
Totale				39.300.000,00	19.257.000,00